

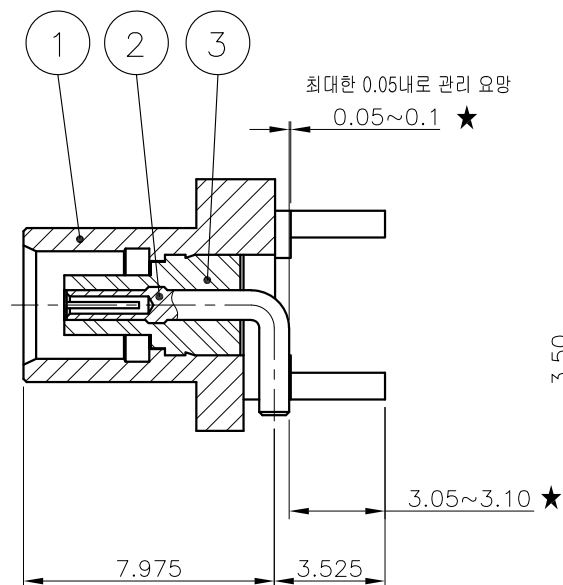
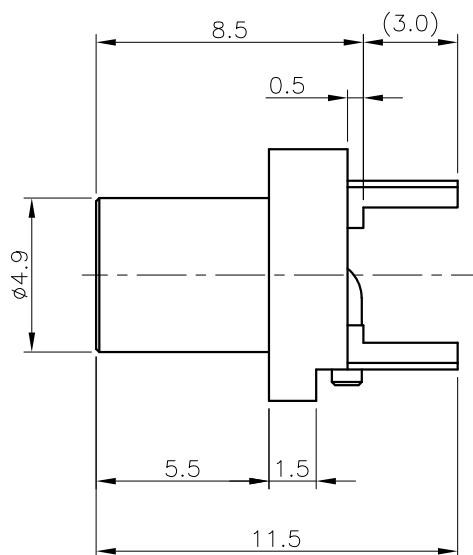
ELECTRICAL DATA :

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~6GHz
3. VSWR (Max) : 1.2

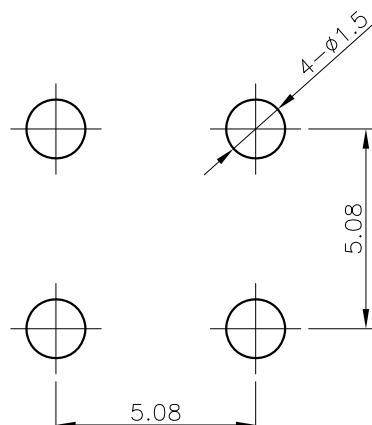
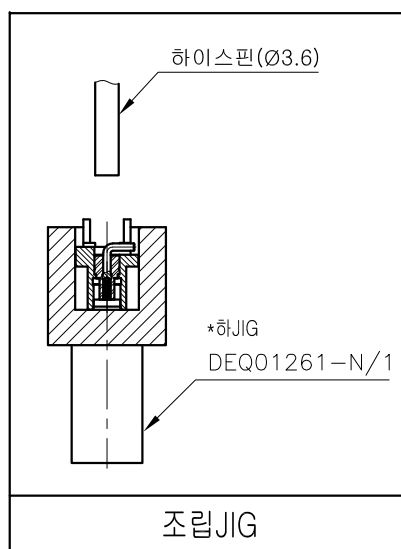
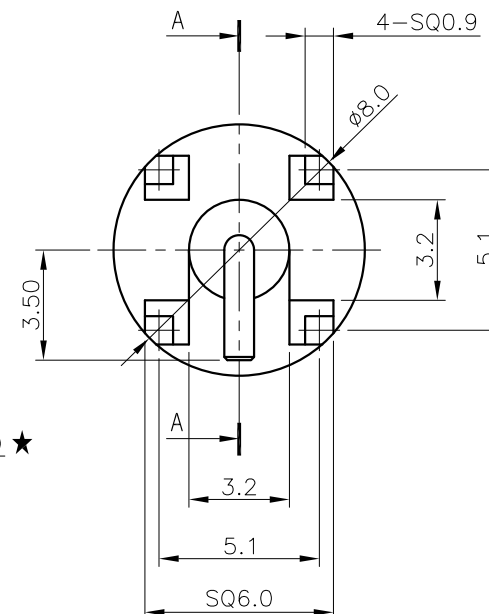
- ★PCB 다리 턱 기준에서 밴딩핀 높이 0.05~0.1관리할 것
-> PCB 다리 턱보다 밴딩핀 돌출되지 않도록 관리
- ★ 생산팀에서는 조립시 전수검사 진행할 것
품질팀에서는 생산팀 조립 시 초/중/종물 치수 확인할 것

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	S.H.KIM	2022.10.25.



SECTION A-A

PCB MOUNTING HOLE SIZE
(SCALE 5:1)

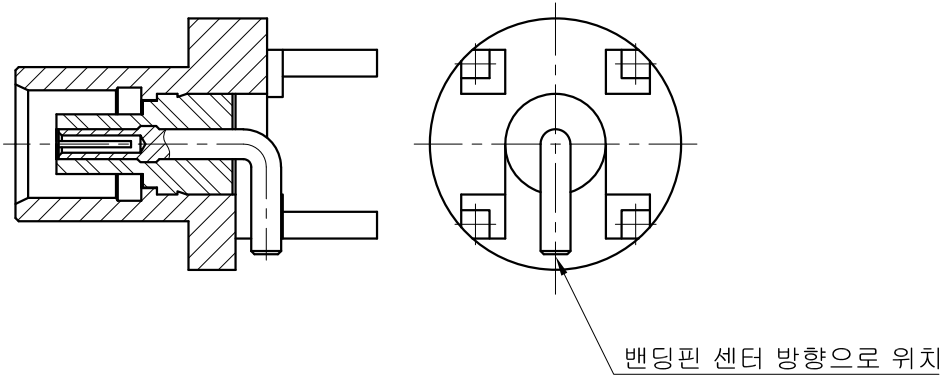
■ 조립방법 2Page 참조

3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN03321-N/2
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT04336-5/2
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate (납땜성향상)	DBD04864-5/2
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

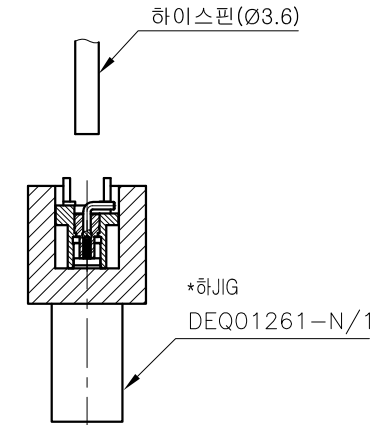
TOLERANCE	Decimal ±0.1	DATE 2022. 10. 25.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	Angle ±1°	APPROVED BY S.H.KIM			
MATERIAL		CHECKED BY		TITLE MCX50 PCB JS-4R	
FINISH		DRAWN BY S.Y.EUN		DWG NO. CN04072-7/2	
SCALE 4/1		UNIT mm		REVISION I R	SHEET 1 of 1

■ 조립방법

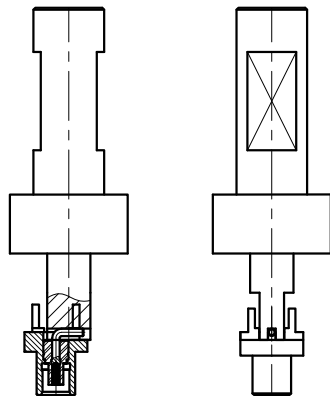
1. ①번 바디에 ③번 절연체 조립한다.
2. ②번 밴딩핀 널링부위까지 가조립 후 아래 그림과 같이 밴딩핀 방향을 잡아준다.
(가조립 시 아래 4번 가이드 JIG : DEQ01233-1/5 사용할 것)



3. 위 조립품을 하JIG에 삽입 후 하이스핀으로 밴딩핀을 눌러준다.
(하 JIG : DEQ01261-N/1)



4. 밴딩핀 방향 가이드 지그를 이용하여 방향 잡아준다.
(가이드 JIG : DEQ01233-1/5)



5. 조립 진행 시 밴딩 핀 높이 품질팀 게이지를 이용하여 확인 한다.

- ★PCB 다리 턱 기준에서 밴딩핀 높이 0.05~0.1관리할 것
-> PCB 다리 턱보다 밴딩핀 돌출되지 않도록 관리
- ★ 생산팀에서는 조립시 전수검사 진행할 것
품질팀에서는 생산팀 조립 시 초/중/종물 치수 확인할 것

